|  |
| --- |
| **ALLEGATO B - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI**  **(versione 20220608)** |
| FORNITURA DI UN SISTEMA PER SPIN COATING, BAKING E SVILUPPO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
| CIG 9259076F37 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI TABELLARI** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di incoerenza tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema. |
| ***A.1 Durata garanzia dei prodotti offerti***   1. 36 mesi 2. 24 mesi 3. 12 mesi |  |
| ***A.2 Tempi di consegna***   1. 14 settimane 2. 16 settimane 3. 18 settimane |  |
| ***B.1 Numero di linee per fotoresist comprese nella fornitura***   1. Più di 3 linee 2. 3 linee 3. 2 linee |  |
| ***B.2 Massimo numero di linee per fotoresist installabili***   1. Più di 5 linee 2. 5 linee 3. 4 linee |  |
| ***B.3 Numero di linee per fotoresist azionate tramite motore***   1. 3 linee 2. 2 linee 3. 1 linea |  |
| ***B.4 Numero di linee per fotoresist azionate pneumaticamente***   1. 3 linee 2. 2 linee 3. 1 linea |  |
| ***B.5 Pulizia automatica dei terminali delle linee di fotoresist***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***B.6 Tool di allineamento per wafer da 4”, 6” e 8” compreso nella fornitura***   1. Presene 2. Assente |  |
| ***B.7 Presenza serbatoio reflui***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***B.8 Pulizia automatica della camera di spin coating (bowl)***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***C.1 Fissaggio del wafer tramite vuoto***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***C.2 Accuratezza del valore di temperatura***   1. +/- 0.6 ° C 2. +/- 0.8 ° C 3. 1° C |  |
| ***D.1 Numero di linee per developer comprese nella fornitura***   1. 3 linee 2. 2 linee 3. 1 linea |  |
| ***D.2 Massimo numero di linee per developer installabili***   1. Più di 3 linee 2. 3 linee 3. 2 linee |  |
| ***D.3 Erogatori per risciacquo del retro del campione (backside rinse)***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***D.4 Camera di processo riscaldabile***   1. Presente 2. Assente |  |
| ***D.5 Presenza serbatoio reflui***   1. Presente 2. Assente |  |